

3EC-HTE

- ・ 圧延銅箔同様にアニールにより再結晶する高伸び・高屈曲電解銅箔。
High Elongation and flexibility after annealing, equally with RA copper foil.
- ・ 2011年より日本だけでなく台湾・マレーシア拠点でも一部生産開始し、安定供給が可能です。
Stable supply is available because of 3-factory-production.

用途/Application

- ・ 多層プリント配線板
/High Density Interconnect
- ・ フレキシブルプリント基板
/Flexible Print Board

構成/Composition



生産拠点/Production Site

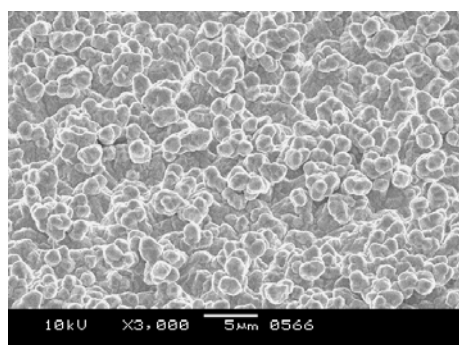
- ・ 日本/Japan
- ・ 台湾/Taiwan
- ・ マレーシア/Malaysia

代表的特性値/Representative data

	μm	Area weight (g/m^2)	Laminate side $\text{Rz}(\mu\text{m})$	Tensile Strength (N/mm^2)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
3EC-HTE	18	153	5	390	10	1.4
	35	285	7	390	15	1.8

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative data, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

